

F2_040401_560000_04

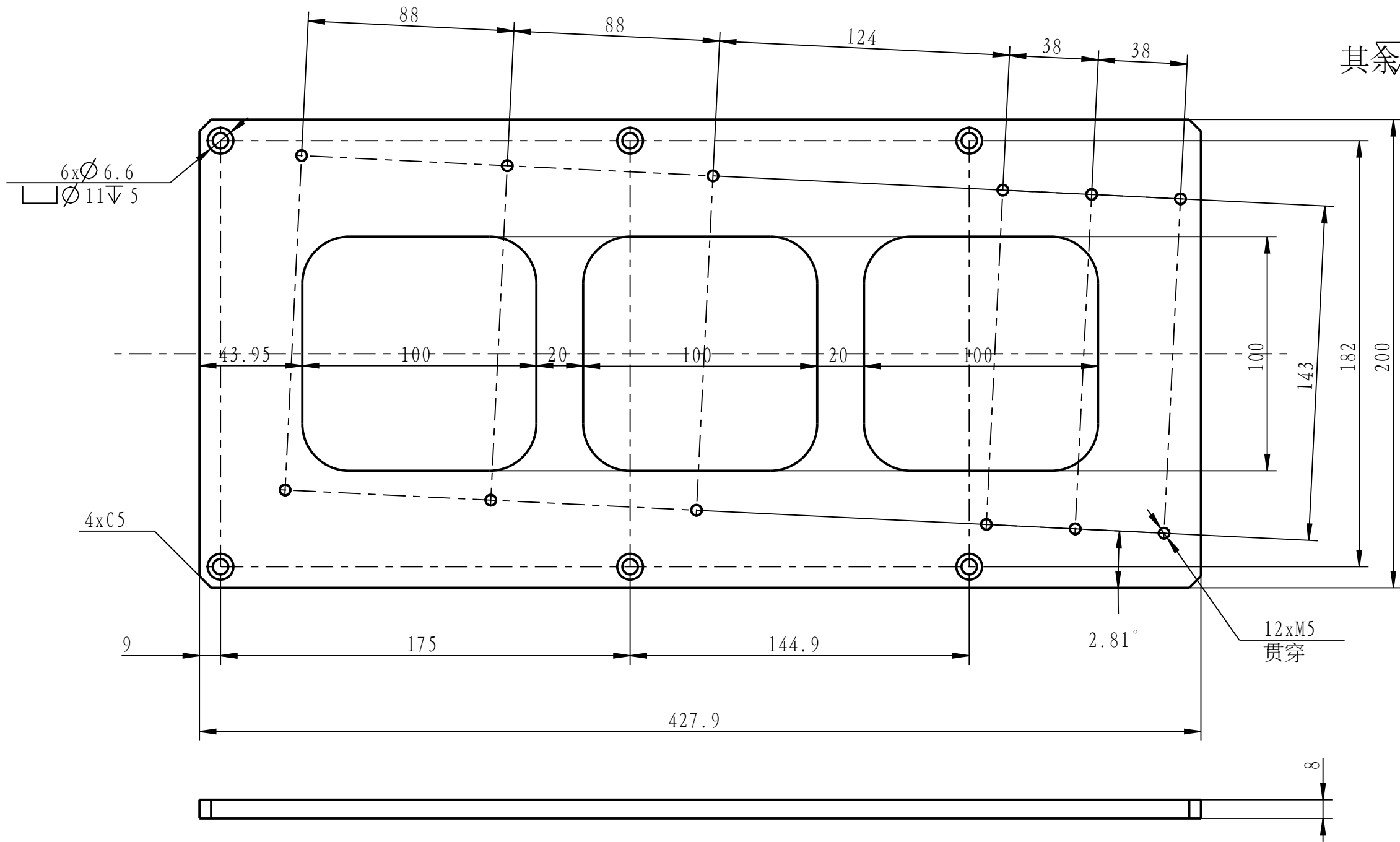
合图

密级:

表面处理

激光膜

热处理



技术要求

1. 未注尺寸按GB/T1804-m, 未注形位公差按GB/1184-K;
2. 锐边倒角, 去毛刺。

(借)用件登记
旧底图总号

底图总号

制 图

签 收

日 期

					6061		哈尔滨工业大学	
标记	处数	更改文件号	签字	日期				
设计			会签		重量	3.50	100*100*10假负载转接板(斜孔-3)	
校对					件数			
			标准化		比例	1:2	F2_040401_560000_04	
审核			审批		阶段标记	E		
工艺			批准		共 1 张	第 1 张		